# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

# PANT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-247415

(43)Date of publication of application: 26.09.1995

(51)Int.CI.

CO8L 71/12 CO8L 71/12 CO8G 65/48 CO8K 3/36 CO8K 5/02 CO8K 5/3477 CO8L 53/02 // B32B 15/08

(21)Application number: 06-039515

(71)Applicant : ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

10.03.1994

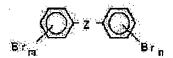
(72)Inventor: KUROKI MASAKATSU

KATAYOSE TERUO

# (54) FLAME RETARDED AND CURABLE POLYPHENYLENE ETHER RESIN COMPOSITION (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject composition, comprising a polyphenylene ether resin, triallyl (iso)cyanurate, silica, a specific hydrogenated block copolymer and a specified compound, having excellent flame retardancy, chemical and heat resistances and dielectric characteristics and useful for the electronic industry, etc.

CONSTITUTION: This resin composition comprises (A) 98–40 pts.wt. polyphenylene ether resin containing unsaturated groups, (B) 2–60 pts.wt. triallyl isocyanurate and/or triallyl cyanurate, (C) 10–400 pts.wt. silica, (D) 1–50 pts.wt. hydrogenated block copolymer prepared by hydrogenating a block copolymer comprising at least one polymer block (a) consisting essentially of a vinyl aromatic compound and at least one polymer block (b) consisting essentially of a conjugated diene compound and (E) 5–50 pts.wt. compound expressed by the formula {(m) and (n) each is 3–5; [(m)+(n)]≥8; Z is a 1–4C alkyl or a bromine-substituted alkyl} based on 100 pts.wt. total amount of the components (A) and (B).



#### **LEGAL STATUS**

Date of request for examination

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal ag examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-247415

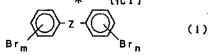
(43)公開日 平成7年(1995)9月26日

(51) Int.Cl.*		識別配号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所
COSL	71/12	LQN							
		LQP							
C08G	65/48	NQU							
C08K	3/36								
	5/02								
			審查請求	未請求	館求項	iの数 5	OL	(全 18 頁)	最終質に続く
(21)出願番号		<b>特顧平6-39515</b>		(71)	出願人	00000	0033		
				ŀ		旭化成	江菜株	式会社	
(22)出願日		平成6年(1994)3月	₹10日			大阪府	<b>大阪市</b>	北区堂島浜1	丁目2番6号
				(72)	発明者	黒木	正勝		
						神奈川	県川崎	市川崎区夜光	1丁目3番1号
						旭化	成工業	株式会社内	
				(72)	発明者	片寄	照雄		
								市川崎区夜光 株式会社内	1丁目3番1号
						ABIL	11/Ve-11/545*	NY TAXETTLY	
·									
									•

#### (54) 【発明の名称】 難燃化硬化性ポリフェニレンエーテル樹脂組成物

#### (57)【要約】

【目的】 ポリフェニレンエーテル系樹脂の優れた誘電 特性を損なうことなく、硬化後において優れた耐薬品 性、耐熱性に加えて、優れた難燃性を有するポリフェニ レンエーテル系樹脂組成物を得る。 \*【構成】 所定量のポリフェニレンエーテル樹脂、トリアリル(イソ)シアヌレート、シリカ、水添ブロック共重合体および一般式(1)で表される化合物を含むポリフェニレンエーテル系樹脂組成物を得る。



m, nは8~5の整数でかつm+nは8以上、2は炭素数4以下のアルキル基または臭素置換アルキル基である。

#### 【特許請求の範囲】

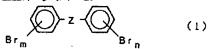
(a)、(a)成分と(b)成分の和1 【請求項1】 00重量部を基準として、98~40重量部の不飽和基 を含むポリフェニレンエーテル樹脂、(b)、(a)成 分と(b)成分の和100重量部を基準として、2~6 0重量部のトリアリルイソシアヌレートおよび/または トリアリルシアヌレート、(c)、(a)成分と(b) 成分の和100重量部を基準として、10~400重量 部のシリカ、および (d)、(a)成分と(b)成分の 和100重量部を基準として、1~50重量部の少なく\*10

1

\*とも1個のビニル芳香族化合物を主体とする重合体プロ ックAおよび少なくとも1個の共役ジエン化合物を主体 とする重合体ブロックBとから成るブロック共重合体を 水素添加して得られる水添ブロック共重合体

(e)、(a)成分と(b)成分の和100重量部を基 準として、5~50重量部の一般式(1)で表される化 合物からなることを特徴とする硬化性ポリフェニレンエ ーテル系樹脂組成物。

(化1)



#### nは8~5の整数でかつm+nは8以上、2は炭素数4以下のアルキル基 または臭素置換アルキル基である。

【請求項2】 請求項1記載の硬化性ポリフェニレンエ ーテル系樹脂組成物を硬化して得られた硬化ポリフェニ レンエーテル系樹脂組成物。

【請求項3】 (a)、(a)成分と(b)成分の和1 20 縁材料、耐熱材料に用いることができる。 00重量部を基準として、98~40重量部の不飽和基 を含むポリフェニレンエーテル樹脂、(b)、(a)成 分と(b)成分の和100重量部を基準として、2~6 0重量部のトリアリルイソシアヌレートおよび/または トリアリルシアヌレート、(c)、(a)成分と(b) 成分の和100重量部を基準として、10~100重量 部のシリカ、(d)、(a)成分と(b)成分の和10 ○重量部を基準として、1~50重量部の少なくとも1 個のビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロックA 重合体プロック Bとから成るプロック共軍合体を水素派 加して得られる水添ブロック共重合体

(e)、(a)成分と(b)成分の和100重量部を基 準として、5~50重量部の一般式(1)で表される化 合物、(f)、(e)成分100重量部を基準として、 10~50重量部の酸化アンチモン、および(g)、 (a)~(g)成分の和100重量部を基準として、5 ~90重量部の基材からなることを特徴とする硬化性複

【請求項4】 請求項3記載の硬化性複合材料を硬化し 40 て得られた硬化複合材料。

【請求項5】 請求項4記載の硬化複合材料と金属箔か らなる積層体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

合材料。

【産業上の利用分野】本発明は硬化性ポリフェニレンエ ーテル系樹脂組成物およびこれを硬化して得られる硬化 体に関する。さらに本発明は、該樹脂組成物と基材から なる硬化性複合材料、その硬化体、および硬化体と金属 箔からなる積層体に関する。

【0002】本発明の樹脂組成物は、硬化後において優 れた難燃性、耐薬品性、誘電特性、耐熱性を有し、電子 産業、宇宙・航空機産業等の分野において誘電材料、絶

[0003]

【従来の技術】近年、通信用、民生用、産業用等の電子 機器の分野における実装方法の小型化、高密度化への指 向は著しいものがあり、それに伴って材料の面でもより 優れた耐熱性、寸法安定性、電気特性、成形性が要求さ れつつある。例えばブリント配線基板としては、従来か **らのフェノール樹脂やエポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂** を基材とした銅張り積層板が用いられてきた。これらは 各種の性能をバランス良く有するものの、電気特性、特 および少なくとも1個の共役ジエン化合物を主体とする 30 に高周波領域での誘電特性が悪いという欠点を持ってい る。との問題を解決する新しい材料としてポリフェニレ ンエーテルが近年注目をあび銅張り積層板への応用が試 みられている。

> 【0004】ポリフェニレンエーテルは機械的特性と電 気的特性に優れたエンジニアリングプラスチックであ り、耐熱性も比較的高い。しかしながらブリント基板材 料として利用しようとした場合、極めて高いハンダ耐熱 性が要求されるため、ポリフェニレンエーテル本来の耐 熱性では決して十分とは言えない。即ち、ポリフェニレ ンエーテルは200℃以上の高温に曝されると変形を起 とし、機械的強度の著しい低下や、樹脂表面に回路用と して形成された銅箔の剥離を引き起とす。またポリフェ ニレンエーテルは、酸、アルカリ、熱水に対しては強い 抵抗性を有するものの芳香族炭化水素化合物やハロゲン 置換炭化水素化合物に対する抵抗性が極めて弱く、これ らの溶媒に溶解する。

【0005】ポリフェニレンエーテルの耐熱性と耐薬品 性を改善する一つの方法として、ポリフェニレンエーテ ルの鎖中に架橋性の官能基を導入しさらに硬化させて硬 50 化ポリフェニレンエーテルとして利用する方法が提案さ

れている。具体例を挙げると、2 - アリル - 6 - メチル フェノールまたは2、6・ジアリルフェノールの重合体 *M*Journal of Polymer Scien ce誌, 第49巻, 267頁(1961) に開示されて いる。米国特許第3281393号および同34220 62号には、2、6・ジメチルフェノールと2・アリル 6 - メチルフェノールまたは2, 6 - ジアリルフェノ -ルとの共重合体が開示されている。また米国特許第4 634742号には、ビニル基置換ポリフェニレンエー テルが開示されている。さらに本発明者らは、先にブロ 10 パルギル基あるいはアリル基で置換されたポリフェニレ ンエーテル、ならびに三重結合あるいは二重結合を含む ポリフェニレンエーテルを発明し、これらが硬化可能で あること、そして得られる硬化体は芳香族炭化水素溶媒 やハロゲン置換炭化水素溶媒に不溶であり優れた誘電特 性を持つことを見い出した(特別平1・69628号) 同1-69629号、同1-113425号、同1-1 13426号)。

【0006】しかし、ポリフェニレンエールテル自身は 銅張積層板のような電気部品に用いるために十分な難燃 20 性を有してはいない。ポリフェニレンエーテルの優れた 誘電特性および耐熱性を損なわずに難燃性を付与することは実用上強く求められているにもかかわらず、その有 効な一手段であるデカブロモジフェニルエーテル類縁化 合物の添加は環境保護の観点から制限もしくは禁止の方 向にある。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、ポリフェニレンエーテル樹脂の優れた誘電特性を損なうてと無く、硬化後に 30 おいて優れた耐薬品性、耐熱性に加えて、優れた難燃性を有する硬化物を示す、新規な硬化性樹脂組成物を提供しようとするものである。

【0008】以上の部分はプリント配線板用積層板を例 に引いて述べたが、との樹脂組成物を他の成形体としても好適に用い得ることはいうまでもない。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上述のような課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、本発明の目的に沿った新規な樹脂組成物を見いたし本発明を完成 40 するに至った。本発明は次に述べる5つの発明により構成される。本発明の第1は、(a)、(a)成分と

- (b)成分の和100重量部を基準として、98~40 重量部の不飽和基を含むポリフェニレンエーテル樹脂、
- (b)、(a)成分と(b)成分の和 I 0 0 重量部を基準として、2~6 0 重量部のトリアリルイソシアヌレートおよび/またはトリアリルシアヌレート、(c)、
- (a)成分と(b)成分の和100重量部を基準として、10~400重量部のシリカ、および(d)、
- (a)成分と(b)成分の和100重量部を基準とし

て、1~50重量部の少なくとも1個のビニル芳香族化合物を主体とする重合体プロックAおよび、少なくとも1個の共役ジェン化合物を主体とする重合体プロックBとから成るプロック共重合体を水素添加して得られる水添プロック共重合体

(e)、(a)成分と(b)成分の和100重量部を基準として5~50重量部の一般式(1)で表される化合物からなることを特徴とする硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂組成物を提供する。

【0010】本発明の第2は、上記第1発明の硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂組成物を硬化して得られた硬化ポリフェニレンエーテル系樹脂組成物を提供する。本発明の第3は、(a)、(a)成分と(b)成分の和100重量部を基準として、98~40重量部の不飽和基を含むポリフェニレンエーテル樹脂、(b)、(a)成分と(b)成分の和100重量部を基準として、2~60重量部のトリアリルイソシアヌレートおよび/またはトリアリルシアヌレート、(c)、(a)成分と

(b)成分の和100重量部を基準として、10~100重量部のシリカ、(d)、(a)成分と(b)成分の和100重量部を基準として、1~50重量部の少なくとも1個のビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロックAおよび、少なくとも1個の共役ジエン化合物を主体とする重合体ブロックBとから成るブロック共重合体を水素添加して得られる水添ブロック共重合体

(e)、(a)成分と(b)成分の和100重量部を基準として、5~50重量部の一般式(1)で表される化合物、(f)、(e)成分100重量部を基準として、10~50重量部の酸化アンチモン、および(g)、

) (a)~(e)成分の和100重量部を基準として、5 ~90重量部の基材からなることを特徴とする硬化性複 合材料を提供する。

【0011】本発明の第4は、上記第3発明の硬化性複合材料を硬化して得られた硬化複合材料を提供する。本発明の第5は、上記第4発明の硬化複合材料と金属箔からなる積層体を提供する。これらの発明について以下に詳しく説明する。

【0012】まず本発明の第1 および第2 である硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂組成物とその硬化体について説明する。硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂組成物の(a)成分として用いられる不飽和基を含むポリフェニレンエーテル樹脂とは、ポリフェニレンエーテル類に対して側鎖として炭素 - 炭素二重結合および/または炭素 - 炭素三重結合を含む不飽和基を導入したものを指す。その例としては、次の一般式(I)で表されるポリフェニレンエーテル樹脂と一般式(III)のアルケニルハライドおよび/または一般式(IV)のアルキニルハライドの反応生成物から成る樹脂であって、

[0013]

50 【化2】

[式中、mは1~6の整数であり、Jは次式(I I)で表される単位から、実質 的に構成されるポリフェニレンエーテル値であり

Qはmが1のとき水素原子を表し、mが2以上のときは一分子中に2~6 個のフェノール性水酸基を持ち、フェノール水酸基のオルト位およびパラ位に乗合不活性な直接基を有する多言能性フェノール化合物の残基を表す。]

[0014]

$$Y + C + 2 = C - R_4$$

[式中、1、Kは各々独立に $1\sim4$ の整数であり、X、Yは各々独立に塩素、臭 衆または90余であり、 $R_1\sim R_1$ は各々独立に水素、メチル基またはエチル基である。]

【0015】Xおよび/またはY、下記アルケニル基お ※できる。 よび/またはアルキニル基がそれぞれ共有的にポリフェ 30 【0016】 ニレンエーテル樹脂に結合している樹脂を挙げるととが※ 【化4】

$$-\left\langle CH_{2}\right\rangle_{1} C = C \left\langle R_{1} \right\rangle_{R_{2}}$$
 (111')

$$\frac{\langle c H_2 \rangle_k - c = c - R_4}{\langle i v' \rangle}$$

【0017】一般式(I)のポリフェニレンエーテル樹 【0018】 脂について説明すると、Qの代表的な例としては、次の 40 【化5】 4種の一般式で表される化合物群が挙げられる。

$$A_{1}$$

$$A_{1}$$

$$A_{2}$$

$$A_{1}$$

$$A_{2}$$

$$A_{3}$$

$$A_{4}$$

$$A_{2}$$

$$A_{2}$$

$$A_{3}$$

$$A_{4}$$

$$A_{5}$$

$$A_{7}$$

$$A_{1}$$

$$A_{1}$$

$$A_{2}$$

$$A_{3}$$

$$A_{4}$$

$$A_{5}$$

$$A_{6}$$

$$A_{7}$$

$$A_{7}$$

$$A_{8}$$

$$A_{1}$$

$$A_{1}$$

$$A_{2}$$

$$A_{3}$$

$$A_{4}$$

$$A_{5}$$

$$A_{7}$$

$$A_{8}$$

$$A_{8}$$

$$A_{8}$$

$$A_{8}$$

$$A_{8}$$

$$A_{8}$$

$$A_{8}$$

$$A_{8}$$

$$A_{8}$$

(式中、A1、A2は同一または異なる炭素数1~4の直鎖状アルキル基を表し、X1は間筋炭炭化水素残基およびそれらの直換誘導体、アラルキル基およびそれらの置換誘導体、酸素、硫黄、スルホニル基、カルボニル基を表し、Y1は脂肪炭炭化水素残基およびそれらの置換誘導体、芳香炭炭化水素残基およびそれらの置換誘導体、アラルキル基およびそれらの置換誘導体を表し、Z1は酸素、硫黄、スルホニル基、カルボニル基を表しA2と直接結合した2つのフェニル基、A2とX1、A2とY1、A2とZ1の結合位置はすべてフェノール性水酸基のオルト位およびバラ位を示し、rは0~4、Sは2~6の整数を表す。)

【0019】具体例として、

[0020]

【化6】

#### 特開平7-247415

10

【0022】等がある。一般式(I)中のJで表されるポリフェニレンエーテル鎖中には、該ポリフェニレンエーテル樹脂の耐熱性、熱安定性を低下させない限りにおいて以下に述べる単位または末端基のうち一種または二種以上が含まれていてもよい。

i)次の一般式で表される単位であって(II)以外のもの、

[0023] [化8]

10

(6)

[0021] [化7]

30

3

40

(7)

特開平7-247415

17

(式中、R。~R。は各々独立の水葉、アルキル芸、置換アルキル芸、ナリール芸、 置換アリール芸を姿す。)

【0024】ii)次の一般式で表される単位、

10米 (化9)

[0025]

R10 R9 (VI)

R11 C N R14 R15

R12 R13

(式中、R₀~R₁₀は各々独立の水素、アルキル基、面換アルキル基、アリール基、 面換アリール基を表し、R₁₀、R₁₀が同時に水素であることはない。)

【0026】iii)次の一般式で表される末端基、

※【化10】

[0027]

R17 R16 Ar R23 R22

R20 R21

(1 I V)

(式中、R1。~R1。は各々独立に水素、アルキル基、置換アルキル基、アリール 基、置換アリール基を表し、R21~R1。は各々独立に水素、アルキル基、置換ア ルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アリール基、置換アリール基を表 し、Arはアリール基、置換アリール基を表す。)

【0028】iv)上記式(II)および一般式(V) 40~(VII)の単位または末端基に対し、スチレン、メタクリル酸メチルなどの不飽和結合を持つ重合性モノマーをグラフト重合させて得られる単位または末端基。一般式(V)の単位の例としては、

о-

- С нз

[0029]

[1211]

(ここでPhはフェニル基を表す。)

[0030]等が挙げられる。一般式(VI)の単位の 50 例としては、

[0031] [(£12]

【0032】等が挙げられる。一般式 (VII) の末端 基の例としては、

[0033]

[化13]

【0034】等が挙げられる。次に一般式(III)の アルケニルハライドの具体的な例を挙げると、アリルク ロライド、アリルブロマイド、アリルアイオダイド、4 ーブロモー1ープテン、トランスーおよび/またはシス ー1ープロモー2ープテン、トランスーおよび/または シスー1ークロロー2ープテン、1ークロロー2ーメチ ルー2ープロペン、5ープロモー1ーペンテン、4ーブ\* \*ロモ-2-メチル-2-ブテン、6-ブロモ-1-ヘキセン、5-ブロモ-2-メチル-2-ペンテン等がある

【0035】一般式(IV)のアルキニルハライドの具体的な例を挙げるとプロパルギルクロライド、プロバルギルブロマイド、プロバルギルアイオダイド、4ープロモー1ーブチン、4ープロモー2ーブチン、5ープロモー1ーベンチン、5ープロモー2ーベンチン、1ーヨードー2ーベンチン、1ーヨードー3ーへキシン、6ープロモー1ーへキシン等がある。

【0036】 これらのアルケニルハライドおよびアルキニルハライドは、一種のみあるいは二種以上をあわせて用いることができる。本発明の(a)成分に用いられる不飽和基が導入されたポリフェニレンエーテル樹脂は、例えば特開昭64-69628号、同64-69629号、特開平1-113425号、同1-113426号、同2-232260号、同2-233759号に開示された方法に従い、一般式(I)のポリフェニレンエーテル樹脂を有機金属でメタル化し、続いてアルケニルハライド(II) および/またはアルケニルハライド(IV)で置換反応することにより製造することができる。

【0037】本方法に従って製造される不飽和基を含むポリフェニレンエーテル樹脂は、少なくとも次の2種ないし3種の構造式で表される単位より構成される。

[0038]

【化14】

(8)

(武中、Rは前紀アルケニル茲(I I I' )および/またはアルキニル茲(I V' )を表す。]

【0039】さらには上記の他、次の単位を含むこともある。

【0040】 【化15】

〔式中、Mはハロゲンまたは水素原子を表す。〕

【0041】上記一般式(VIII) に由来するハロゲ ンの含量は、酸ポリフェニレンエーテル樹脂を基準とし て0以上(Mが水素原子の場合)30重量%以下の範囲 であり、より好ましくは0以上20重量%以下の範囲で ある。本発明に用いられる不飽和基が導入されたポリフ ェニレンエーテル樹脂中には、必ずしもハロゲンが含ま れる必要はない。しかしながらハロゲンが特に塩素、臭 素である場合には、本発明の硬化性ポリフェニレンエー テル系樹脂組成物に難燃性を付与できるという効果があ

【0042】上記の方法で得られる不飽和基が導入され たポリフェニレンエーテル樹脂の好ましい例としては、 以下に述べるポリフェニレンエーテル系樹脂とアリルブ ロマイド、アリルクロライド、プロパルギルブロマイ ド、プロパルギルクロライドの反応生成物からなる樹脂 を挙げることができる。ポリフェニレンエーテル系樹脂 としては、2,6-ジメチルフェノールの単独重合で得 ちれるポリ(2,6-ジメチル-1,4-フェニレンエ ーテル)、ポリ(2,6-ジメチル-1,4-フェニレ ンエーテル)のポリスチレングラフト共重合体、2,6 30 -ジメチルフェノールと2、3、6-トリメチルフェノ ールの共重合体、2,6-ジメチルフェノールと2,6 ジメチル-3-フェニルフェノールの共重合体、2, 6-ジメチルフェノールを多官能性フェノール化合物 [0043]

(化16]

$$Q + H$$

【0044】の存在下で重合して得られた多官能性ポリ フェニレンエーテル樹脂、例えば特開昭63-3012 22号、特開平1-29748号に開示されているよう な一般式(V)および(VI)の単位を含む共重合体、 例えば特願平1-135763号に開示されているよう な一般式(V)の単位および一般式(VII)の末端基 を含む樹脂等を挙げることができる。

【0045】本発明の硬化性ポリフェニレンエーテル系 樹脂組成物に用いられる不飽和基を含むポリフェニレン エーテル樹脂の他の例としては、次のような繰り返し単 50 ジメチルフェノールの共重合体等が挙げられる。

位を含む樹脂を挙げることができる。

(VIII)

[0046]

【化17】

20

〔式中、Rss. Rssは各々独立の水煮、アルキル基、フェニル基を表す。〕

【0047】具体的な例としては、米国特許第3422 062号に開示されているような2-アリル-6-メチ ルフェノールと、2、6-ジメチルフェノールの共重合 体、米国特許第3281393号に開示されているよう な2,6-ジアリル-4-プロモフェノールと2,6-シメチルー4ープロモフェノールの共重合体、特公昭6 3-47733号に開示されているような2、6-ジブ レニルフェノールと2、6-ジメチルフェノールの共重 合体、同じく2, 6-ビス(2-ブテニル)フェノール と2. 6-ジメチルフェノールの共重合体、同じく2. 6-ジシンナミルフェノールと2、6-ジメチルフェノ ールの共重合体、特開昭58-27719号の開示され ているような2-プレニル-6-メチルフェノールの単 独重合体、同じく2-プレニル-6-メチルフェノール と2,6-ジメチルフェノールの共重合体、同じく2-(2-プテニル) -6-メチルフェノールの単独重合 体、同じく2-(2-プテニル)-6-メチルフェノー ルと2,6-ジメチルフェノールの共重合体、同じく2 ーシンナミルー6-メチルフェノールの単独重合体、同 じく2-シンナミル-6-メチルフェノールと2,6-

【0048】また米国特許第4634742号に開示さ れたポリ(2, 8-ジメチル-1, 4-フェニレンエー テル)の2,6位のメチル基をピニル基に変換して得ら れる樹脂、同じくポリ(2,6-ジメチル-1,4-フ ェニレンエーテル) のフェニル基の3.5位にピニル基 を導入して得られる樹脂も本発明に用いられる不飽和基 を含むポリフェニレンエーテル樹脂の好ましい例の-である。

17

\*【0049】本発明において用いられる不飽和基を含む ポリフェニレンエーテル樹脂の不飽和基の含量の範囲 は、次式の定義に従った場合0、1モル%以上100モ ル%以下、より好ましくは0.5モル%以上50モル% 以下が好適である。

[0050]

【数1】

不飽和器の全モル数 不飽和基の含量 =

フェニル基の全モル数

(モル%)

【0051】不飽和基の含量が0.1モル%未満では硬 化後の耐薬品性の改善が不十分となるので好ましくな い。逆に100モル%を越えると硬化後において非常に 脆くなるので好ましくない。また本発明において用いら れる不飽和基が導入されたポリフェニレンエーテル樹脂 の分子量については、30℃, 0.5g/d1のクロロ ホルム溶液で測定した粘度数η s p/cが0.1~1. 0の範囲にあるものが良好に使用できる。溶融樹脂流れ 線板用プリブレグとしては、粘度数の小さい樹脂が好ま しい。

【0052】本発明のポリフェニレンエーテル系樹脂組 成物の(b)成分として用いられるトリアリルイソシア ヌレートおよび/またはトリアリルシアヌレートとは、 それぞれ次の構造式で表される3官能性モノマーであ る。

[0053] [化18]

【0054】本発明を実施する上においては、トリアリ ルイソシアヌレートおよびトリアリルシアヌレートはそ れぞれ単独で用いられるだけでなく、両者を任意の割合 で混合して用いることが可能である。本発明において、 トリアリルイソシアヌレートおよびトリアリルシアヌレ ートは、可塑剤ならびに架橋剤としての効果を発揮す る。すなわち、ブレス時の樹脂流れの向上と架橋密度の 向上をもたらす。

【0055】本発明のポリフェニレンエーテル系樹脂組 50

成物の(c)成分として用いられるシリカとは、化学的 には二酸化ケイ素(SiO,)である。以下一般に用い られている通称であるシリカを用いる。本発明のポリフ ェニレンエーテル系樹脂組成物の(c)成分は、硬化後 の樹脂組成物の寸法安定性の向上に寄与するという特徴 を有し、かつ硬化組成物の機械的特性および誘電特性に 悪影響を与えない。

【0056】本発明のポリフェニレンエーテル系樹脂組 を重視する硬化性樹脂組成物、例えば封止材料や多層配 20 成物には、必要に応じて(c)成分と樹脂との界面にお ける接着性を改善する目的で、あらかじめカップリング 剤処理した(c)成分を用ることができる。カップリン グ剤としては、シランカップリング剤、チタネートカッ ブリング剤、アルミニウム系カップリング剤、ジルコア ルミネートカップリング剤等一般のものが使用できる。 また、(a)~(c)成分を混合する際に上記カップリ ング剤を添加してもよい。

> 【0057】また、(c)成分の粒子形状や粒径は特に 規定しないが、好ましくは破砕タイプの粒子形状で平均 30 粒径4~10μの粒度分布の広いものがよい。さらに、 破砕タイプと球状タイプを混合して用いてもよい。本発 明のポリフェニレンエーテル系樹脂組成物の(d)成分 として用いられる水添ブロック共重合体は、少なくとも 1個のビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック Aと、少なくとも1個の共役ジェン化合物を主体とする 重合体ブロックBとから成るブロック共重合体を水素添 加して得られるものであり、例えば、

[0058]

[化19]

40

B - A - B - A

19

$$\left(A-B\right) \longrightarrow Si$$

$$\left\{ B-A-B \right\}_{i}$$

【0059】等の構造を有するビニル芳香族化合物-共 役ジェン化合物プロック共重合体の水素添加されたもの である。この水添ブロック共重合体は、ビニル芳香族化 合物を5~85重量%、好ましくは10~70重量%含 20 むものである。さらにブロック構造について言及する と、ビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロックA が、ビニル芳香族化合物のみからなる重合体プロックま たはピニル芳香族化合物を50重量%を越え、好ましく は70重量%以上含有するビニル芳香族化合物と水素添 加された共役ジェン化合物との共重合体ブロックの構造 を有しており、そしてさらに、水素添加された共役ジェ ン化合物を主体とする重合体ブロックBが、水素添加さ れた共役ジェン化合物のみからなる重合体プロック、ま たは水素添加された共役ジェン化合物を50重量%を越 え、好ましくは70重量%以上含有する水素添加された 共役ジェン化合物とビニル芳香族化合物との共重合体ブ ロックの構造を有するものである。また、これらのビニ ル芳香族化合物を主体とする重合体ブロックA、水素添 加された共役ジェン化合物を主体とする重合体ブロック Bは、それぞれの重合体プロックにおける分子鎖中の水 累添加された共役ジェン化合物またはビニル芳香族化合 物の分布が、ランダム、テーバード(分子鎖に沿ってモ ノマー成分が増加または減少するもの)、一部ブロック 状またはこれらの任意の組み合わせで成っていてもよ く、酸ビニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロック および該水緊添加された共役ジェン化合物を主体とする 重合体ブロックがそれぞれ2個以上ある場合は、各重合 体ブロックはそれぞれが同一構造であってもよく、異な る構造であってもよい。

【0060】水添ブロック共重合体を構成するビニル芳 香族化合物としては、例えばスチレン、αーメチルスチ レン、p-メチルスチレン、ビニルトルエン、p-第3 ブチルスチレン等のうちから1種または2種以上が選択 でき、中でもスチレンが好ましい。また水素添加された 50 は、特に限定されないが、通常、ブロック共重合体と変

共役ジェン化合物を構成する水添前の共役ジェン化合物 としては、例えば、ブタジエン、イソブレン、1,3-ペンタジエン、1,3-ジメチル-1,3-ブタジエン 等のうちから1種または2種以上が選ばれ、中でもブタ ジェン、イソプレンおよびとれらの組み合わせが好まし

【0061】また、上配の構造を有する本発明に供する 水添ブロック共重合体の数平均分子量は特に限定されな いが、数平均分子量は5000~1000000、好ま 10 しくは10000~50000、更に好ましくは30 000~30000の範囲で用いるととができる。更 に水添ブロック共重合体の分子構造は、直鎖状、分岐 状、放射状あるいはこれらの任意の組み合わせのいずれ であってもよい。

【0062】 これらのブロック共重合体の製造方法とし ては上記した構造を有するものであればどのような製造 方法であってもかまわない。例えば、特公昭40-23 798号公報に記載された方法により、リチウム触媒等 を用いて不活性溶媒中でビニル芳香族化合物-共役ジェ ン化合物ブロック共重合体を合成し、次いで、例えば特 公昭42-8704号公報、特公昭43-6636号公 報に記載された方法、特に好ましくは特開昭59-13 3203号公報および、特開昭80-79005号公報 **に記載された方法により、不活性溶媒中で水素添加触媒** の存在下に水素添加して、本発明に供する水添ブロック 共重合体を合成することができる。その際、ビニル芳香 族化合物-共役ジエン化合物プロック共重合体の共役ジ エン化合物に基づく脂肪族二重結合は少なくとも80% を水素添加せしめ、共役ジエン化合物を主体とする重合 30 体ブロックを形態的にオレフィン性化合物重合体ブロッ クに変換させることができる。また、ビニル芳香族化合 物を主体とする重合体ブロックAおよび必要に応じて、 共役ジェン化合物を主体とする重合体プロックBに共重 合されているビニル芳香族化合物に基づく芳香族二重結 合の水素添加率については特に限定はないが、水素添加 率を20%以下にするのが好ましい。

[0063]また、このブロック共重合体には、その特 性を損なわない範囲でジカルボン酸基またはその誘導体 を含有する分子単位が結合した変性ブロック共重合体も 40 含まれる。ジカルボン酸基またはその誘導体を含有する 分子単位は、基本となるブロック共重合体に対して通常 0.05~5重量部の範囲で用い得る。上記ジカルボン 酸基またはその誘導体を含有する変性剤としては、マレ イン酸、フマル酸、クロロマレイン酸、イタコン酸、シ ス-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸および これらジカルボン酸の無水物、エステル、アミド、イミ ドなどがある。好ましい変性剤の具体例としては、無水 マレイン酸、マレイン酸、フマル酸が挙げられる。

【0064】この変性ブロック共重合体の製法として

性剤を押出機等により溶融させた状態でラジカル開始剤 を使用あるいは使用せずに反応させる方法が用いられ る。本発明のポリフェニレンエーテル系樹脂組成物の (d)成分は、硬化後の樹脂組成物の強靭性を向上さ せ、かつ硬化組成物のその他の機械的特性および誘電特・ 性に悪影響を与えない。

【0065】本発明の(e)成分として用いられる難燃 剤は、一般式(1)の構造式で表される。m+nは、難 燃化効果の観点から9以上が好ましく10が最も好まし い。乙は任意の個数の水素が臭素置換されていてよい。 炭素の個数は4以下であればいくつでもよいが、-CH , CH, ーが最も好ましい構造として挙げられる。本件 の第三発明における(f)成分の酸化アンチモンは難燃 性の一層の向上を図る目的で用いられる。Sb, O, お よびSb、O、のいずれも用い得るが、Sb、O、がよ り好ましい。(f)成分は第三〜第五発明において難燃 性を得るために必須であるが、第一および第二発明の硬 化(性)樹脂組成物においては必須ではない。しかし、 これを用いて難燃性を向上させることは可能である。 合割合は、第一および第二発明においては、両者の和1 00重量部を基準として(a)成分が98~40重量 部、(b)成分が2~60重量部である。(b)成分が 2重量部未満では耐薬品性の改善が不十分であり好まし くない。逆に60重量部を越えると誘電特性、吸湿特性 が低下し、また硬化後において非常に脆い材料になるの で好ましくない。

【0067】第一、第二発明の硬化(性)樹脂組成物に 用いられる(c)成分の配合割合は、(a)成分と (b) 成分の和100重量部を基準として10~400 30 重量部、好ましくは100~300重量部、より好まし くは150~200重量部である。(c)成分が10重 量部未満のときは、硬化後の樹脂組成物の熱膨張特性の 改善が不十分であり好ましくない。また400重量部を 越えると、溶融成形時の樹脂の流動性および金属箔との 積層体を作成したときの金属箔との密着性が低下するの で好ましくない。

[0068]第一、第二発明における(d)成分の配合 割合は、(a)成分と(b)成分の和100重量部を基 準として1~50重量部、好ましくは1~30重量部、 より好ましくは5~20重量部である。(d)成分が1 重量部未満のときは硬化物の強靭性の改善が不十分であ り好ましくない。また50重量部を越えると、溶融成形 時の樹脂の流動性が低下するので好ましくない。

【0069】(e)成分の配合割合は、(a)成分と (b) 成分の和100重量部を基準として5~100重 量部、好ましくは5~70重量部、より好ましくは5~ 50重量部である。(e)成分が5重量部未満のときは 十分な難燃性が得られがたく、100重量部を越える と、溶融成形時の樹脂の流動性が低下したり、金属箔に 50 維、全芳香族ポリアミド繊維、ポリテトラフルオロエチ

対する接着力が低下することがある。

【0070】本発明の硬化(性)ポリフェニレンエーテ ル系樹脂組成物は、第4発明として後述する硬化複合材 料と同様、金属箔及び/または金属板と張り合わせて用 いることができる。また、第三~第五発明においては、 (a) 成分と(b) 成分の配合割合は、第両者の和10 ○重量部を基準として(a)成分が98~40重量部。 (b) 成分が2~60重量部である。(b) 成分が2重 量部未満では耐薬品性の改善が不十分であり好ましくな い。逆に60重量部を越えると誘電特性、吸湿特性が低 下し、また硬化後において非常に脆い材料になるので好 ましくない。

【0071】第三~第五に用いられる(c)成分の配合 割合は、(a)成分と(b)成分の和100重量部を基 準として10~100重量部、好ましく20~70重量 部、より好ましくは30~50重量部である。(c)成 分が10重量部未満のときは、硬化後の樹脂組成物の熱 膨張特性の改善が不十分であり好ましくない。また10 0重量部を越えると、溶融成形時の樹脂の流動性および 【0068】以上説明した(a)成分と(b)成分の配 20 金属箔との積層体を作成したときの金属箔との密着性が 低下するので好ましくない。

> 【0072】(d)成分の配合割合は、(a)成分と (b)成分の和100重量部を基準として1~50重量 部、好ましくは1~30重量部である。より好ましくは 5~20重量部である。(d)成分が1重量部未満のと きは硬化物の強靭性の改善が不十分であり好ましくな い。また50重量部を越えると、溶融成形時の樹脂の流 動性が低下するので好ましくない。

【0073】(e)成分の配合割合は、(a)成分と (b)成分の和100重量部を基準として5~100重 量部、好ましくは5~70重量部である。より好ましく は5~50重量部である。(e)成分が5重量部未満の ときは十分な難燃性が得られがたく、100重量部を越 えると、溶融成形時の樹脂の流動性が低下したり、金属 箱に対する接着力が低下することがある。

[0074] (f)成分の配合割合は(e)成分100 重量部を基準として10~50重量部、好ましくは10 ~40重量部、最も好ましくは10~30重量部であ る。(f)成分が10重量部未満では難燃剤が(e)成 40 分単独の場合に比べて難燃性の改良効果が十分でなく、 50重量部を越えると溶融成型時の流動性が低下した り、金属箔に対する接着力が低下することがある。 【0075】本発明の硬化性樹脂組成物には、機械的強 度を高め、寸法安定性を増大させるために基材を加える ことができる。本発明に用いられる基材としては、ロー ピングクロス、クロス、チョップドマット、サーフェシ ングマットなどの各種ガラス布、アスベスト布、金属繊

維布およびその他合成もしくは天然の無機繊維布;ポリ ビニルアルコール繊維、ポリエステル繊維、アクリル繊

レン繊維などの合成繊維から得られる織布または不織 布;綿布、麻布、フェルトなどの天然繊維布;カーボン 繊維布:クラフト紙、コットン紙、紙ーガラス混繊紙な どの天然セルロース系布などがそれぞれ単独で、あるい は2種以上併せて用いられる。

23

【0076】本発明の硬化性複合材料における基材の成 分の占める割合は、硬化性複合材料100重量部を基準 として5~90重量部、より好ましくは10~80重量 部、さらに好ましくは20~70重量部である。基材が 5重量部より少なくなると複合材料の硬化後の寸法安定 10 量部である。ラジカル開始剤の代表的な例を挙げると、 性や強度が不十分であり、また基材が90重量部より多 くなると複合材料の誘電特性が劣り好ましくない。

【0077】本発明で用いられる金属箔としては、例え ば銅箔、アルミニウム箔等が挙げられる。その厚みは特 に限定されないが、5~200μm、より好ましくは5 ~105 µ m の範囲である。上記の(a)~(f)成分 を混合する方法としては、三成分を溶媒中に均一に溶解 または分散させる溶液混合法、あるいは押し出し機等に より加熱して行う溶融ブレンド法等が利用できる。溶液 ロホルム、トリクロロエチレンなどのハロゲン系溶媒: ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族系溶媒;テ トラヒドロフランが単独であるいは二種以上を組み合わ せて用いられる。

【0078】本発明の樹脂組成物は、あらかじめその用 途に応じて所望の形に成形してもよい。成形方法は特に 限定されないが、通常は、樹脂組成物を上述した溶媒に 溶解させ好みの形に成形するキャスト法、または樹脂組 成物を加熱溶融し好みの形に成形する加熱溶融法が用い られる。上述したキャスト法と加熱溶融法は単独で行っ 30 てもよい。またそれぞれを組み合わせて行ってもよい。 例えば、キャスト法で作成された本樹脂組成物のフィル ムを数~数十枚積層し、加熱溶融法、例えばブレス成形 機で加熱溶融し、本樹脂組成物のシートを得ることがで

【0079】本発明の複合材料を製造する方法として は、例えば本発明の(a)~(f)成分と必要に応じて 他の成分を前述のハロゲン系、芳香族系、ケトン系等の 溶媒もしくはその混合溶媒中に均一に溶解または分散さ せ、基材に含複させた後乾燥する方法が挙げられる。含 40 漫は浸漬 (ディッピング)、塗布等によって行われる。 含浸は必要に応じて複数回繰り返すことも可能であり、 またこの際組成や濃度の異なる複数の溶液を用いて含浸 を繰り返し、最終的に希望とする樹脂組成および樹脂量 に調整するととも可能である。

[0080] 本発明の複合材料には、必要に応じて樹脂 と基材の界面における接着性を改善する目的でカップリ ング剤を用いることができる。カップリング剤として は、シランカップリング剤、チタネートカップリング 剤、アルミニウム系カップリング剤、ジルコアルミネー 50 ポリフェニレンエーテル、ポリフェニレンエーテル樹脂

トカップリング剤等一般のものが使用できる。本発明の 硬化性樹脂組成物およびその硬化性複合材料は後述する ように加熱等の手段により架橋反応を起こして硬化する が、その際の反応温度を低くしたり不飽和基の架橋反応 を促進する目的でラジカル開始剤を含有させて使用して もよい。

【0081】本発明の樹脂組成物に用いられるラジカル 開始剤の量は(a)成分と(b)成分の和100部を基 準として0.1~10重量部、好ましくは0.1~8重 ベンゾイルパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサ イド、2、5-ジメチルヘキサン-2、5-ジハイドロ バーオキサイド、2、5-ジメチル-2、5-ジ(t-ブチルパーオキシ) ヘキシン-3、ジ-t-ブチルパー オキサイド、tーブチルクミルパーオキサイド、α, α'-ビス(t-ブチルバーオキシ-m-イソプロビ ル) ベンゼン、2, 5 – ジメチルー2, 5 – ジ(t – ブ チルパーオキシ) ヘキサン、ジクミルパーオキサイド、 ジーt-ブチルパーオキシイソフタレート、t-ブチル 混合に用いられる溶媒としては、ジクロロメタン、クロ 20 パーオキシベンゾエート、2.2-ビス(t-ブチルバ ーオキシ) ブタン、2,2-ピス(t-ブチルパーオキ シ) オクタン、2、5 - ジメチル-2、5 - ジ(ベンゾ イルパーオキシ) ヘキサン、ジ (トリメチルシリル) バ ーオキサイド、トリメチルシリルトリフェニルシリルパ ーオキサイド等の過酸化物があるがこれらに限定されな い。また過酸化物ではないが、2、3-ジメチル-2、 3-ジフェニルブタンもラジカル開始剤として使用でき る。しかし、本樹脂組成物の硬化に用いられる開始剤は とれらの例に限定されない。

> 【0082】本発明の樹脂組成物は、その用途に応じて 所望の性能を付与させる目的で本来の性質を損なわない 範囲の量の充填剤や添加剤を配合して用いることができ る。充填剤は繊維状であっても粉末状であってもよく、 カーボンブラック、アルミナ、タルク、餌母、ガラスビ ーズ、ガラス中空球等を挙げることができる。添加剤と しては、酸化防止剤、熱安定剤、帯電防止剤、可塑剤、 顔料、染料、着色剤等が挙げられる。

> 【0083】さらには、添加剤として他の熱可塑性樹 脂、あるいは熱硬化性樹脂を一種または二種以上配合す ることも可能である。熱可塑性樹脂としてはポリエチレ ン、ポリプロピレン、ポリプテン、エチレン・プロピレ ン共重合体、ポリ(4-メチルーペンテン)等のポリオ レフィン類およびその誘導体、ナイロン4、ナイロン 6、ナイロン8・6、ナイロン6・10、ナイロン12 などのポリアミド類およびその誘導体、ポリエチレンテ レフタレート、ポリプチレンテレフタレート、ポリエチ レンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート・ポリ エチレングリコールブロック共重合体などのポリエステ ル類およびその誘導体、ポリフェニレンエーテル、変性

と不飽和カルボン酸または酸無水物との反応生成物、ボ リカーボネート、ポリアセタール、ポリスルフォン、ポ リ塩化ビニルおよびその共重合体、ポリ塩化ビニリデン およびその共重合体、ポリメチルメタクリレート類、ア クリル酸(またはメタクリル酸)エステル共重合体類、 ポリスチレン類、アクリロニトリルスチレン共重合体 類、アクリロニトリルスチレンプタジェン系共重合体等 のポリスチレン類およびその共重合体類、ポリ酢酸ビニ ル類、ポリビニルホルマール、ポリビニルアセタール、 ポリビニルブチラール類、エチレン酢酸ビニル共重合体・10 およびその加水分解物類、ポリビニルアルコール類、ス チレンプタジエンブロック共重合体類、ポリブタジエ ン、ポリイソプレン等のゴム類、ポリメトキシエチレ ン、ポリエトキシエチレン等のポリビニルエーテル類、 ポリアクリルアマイド、ポリホスファーゼン類、ポリエ ーテルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルイ ミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリアミドイミ ド、熱可塑性ポリイミド、芳香族ポリエステル等の液晶 ポリマー、側鎖に液晶成分を含有する側鎖型液晶ポリマ -等が挙げられる。熱硬化性樹脂としてはエポキシ樹 脂、ポリイミド前駆体等が挙げられる。

【0084】本発明の硬化ポリフェニレンエーテル系樹脂組成物は、以上に述べた硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂硬化物組成物を硬化することにより得られるものである。硬化の方法は任意であり、熱、光、電子線等による方法を採用することができる。加熱により硬化を行う場合その温度は、ラジカル開始剤の種類によっても異なるが、80~300℃、より好ましくは120~250℃の範囲で選ばれる。また時間は、1分~10時間程度、より好ましくは1分~5時間である。

【0085】得られた硬化ポリフェニレンエーテル樹脂組成物は、赤外吸収スペクトル法、高分解能固体核磁気共鳴スペクトル法、熱分解ガスクロマトグラフィー等の方法を用いて樹脂組成を解析するととができる。本発明の硬化複合材料は、フィルム状、あるいは少なくとも1種類の金属箔を少なくとも片面に張り合わせた形で用いるととができる。

【0086】本発明の硬化複合材料は、このようにして シリカ 水添って得た硬化性複合材料を加熱等の方法により硬化すること 化よって得られるものである。その製造方法は特に限定 40 社製) されるものではなく、例えば酸硬化性複合材料を複数枚 ガラス 重ね合わせ、加熱加圧下に各層間を接着せしめると同時 に熱硬化を行い、所望の厚みの硬化複合材料を得ること ができる。また一度接着硬化させた硬化複合材料と硬化 【参考を得ることも可能である。積層成形と硬化は、通常熱プレス等を用い同時に行われるが、両者をそれぞれ単独で 行ってもよい。すなわち、あらかじめ積層成形して得た オ硬化あるいは半硬化の複合材料を、熱処理または別の 方法で処理することによって硬化させることができる。 50 (2,

[0087] 成形および硬化は、温度80~300℃、圧力0.1~1000Kg/cm²、時間1分~10時間の範囲、より好ましくは、温度150~250℃、圧力1~100Kg/cm²、時間1分~5時間の範囲で行うととができる。本発明の積層体とは、本発明の硬化複合材料と金属箔より構成されるものである。

【0088】本発明の積層体を製造する方法としては、例えば本発明の硬化性複合材料と、金属箔を目的に応じた層構成で積層し、加熱加圧下に各層間を接着せしめると同時に熱硬化させる方法を挙げることができる。本発明の積層体においては、硬化性複合材料と金属箔が任意の層構成で積層される。金属箔は表層としても中間層としても用いることができる。

【0089】また本発明の硬化性複合材料と金属板より 構成される積層板および、金属箔、硬化性複合材料、お よび金属板より構成される金属張り積層板も製造でき る。積層板に起いては、金属板をベースとしその片面ま たは両面に硬化性複合材料が積層される。金属張り積層 板においては、金属板をベースとしその片面または両面 20 に硬化性複合材料を介して金属箔が積層される。この際 金属箔は最表層として用いられるが、最表層以外に中間 層として用いてもよい。

[0090]上記の他、積層と硬化を複数回繰り返して多層化することも可能である。金属箔および金属板の接着には接着剤を用いることもできる。接着剤としては、エポキシ系、アクリル系、フェノール系、シアノアクリレート系等が挙げられるが、特にこれらに限定されない。上記の積層成形と硬化は、本発明の硬化複合材料と同様の条件で行うことができる。

#### 0 [0091]

【実施例】以下、本発明を一層明確にするために実施例 を挙げて説明するが、本発明の範囲をとれらの実施例に 限定するものではない。以下の実施例には、各成分とし て次のようなものを用いた。

重合開始剤:2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルバーオキシ)ヘキシン-3(日本油脂 バーヘキシン25B;PH25Bと略す)

シリカ: ヒュウズレックス E-2 (龍森 (株) 社製) 水添ブロック共重合体: H1041 (旭化成工業 (株) 社製)

ガラスクロス: Eガラス製、目付48g/m² Dガラス製、目付48g/m³

[0092]

【参考例1】

#### 不飽和基を含むポリフェニレンエーテル樹脂

平均置換率14%、nsp/C=0.62(30℃, 0.5g/d1、クロロホルム溶液)のアリル基置換ポリフェニレンエーテルを特開平1-69629号に開示された公知の方法に従ってnsp/C=0.58のポリ 50(2、6-ジメチル-1、4-フェニレンエーテル)よ

り合成した。とのポリマーをAとする。 [0093]

【参考例2】

#### 不飽和基を含むポリフェニレンエーテル樹脂

参考例1と同様の方法で、平均置換率 I 4%、η s p/ C=0. 44 (30°C, 0. 5g/d1、クロロホルム 溶液)のアリル基置換ポリフェニレンエーテルを nsp /C=0.40 のポリ(2, B-ジメチル-1, 4-フ ェニレンエーテル)より合成した。このポリマーをBと する。

[0094]

【実施例1~10】

#### 硬化性樹脂組成物および硬化樹脂組成物

参考例1 および2 で合成した不飽和基を含むポリフェニ レンエーテル樹脂AまたはB、トリアリル (イソ) シア ヌレート、シリカ、水添ブロック共重合体、一般式 (1) においてZ=-CH, CH,  $-かつm+n=8\sim$ 10としたジフェニルエタン系化合物、およびSb, O ,を表1に示した組成でヘンシェルミキサーで混合し、 ブレス成形機により200°C、30分の条件で成形・硬 20 ロロエチレン性は良好な値であった。結果を表1に示 化させ、厚み約1mmの硬化物を作成した。

【0095】これらの硬化物は、トリクロロエチレン中 で五分間煮沸しても反りおよび外観の変化は認められ ず、寸法安定性は良好であった。また、UL94規格に 相当する燃焼性試験を行ったところ、V‐0相当の難燃 性を示した。ガラス転移温度(Tg)を熱機械分析装置 (TMA) を用いて測定したところ、おおよそ190~ 200℃という良好な値が得られた。結果は表1に示し tc.

[0096]

【参考例3】

ボリフェニレンエーテルと不飽和カルボン酸または酸無 水物で変性反応した生成物

30℃、0.5g/d1のクロロホルム溶液で測定した

粘度数ヵsp/cが0.54のポリ(2.6-シメチル -1、4-フェニレンエーテル) 100重量部と、無水 マレイン酸1.5重量部、および2,5-ジメチルー 2, 5-ジ(t-ブチルパーオキシ)へキサン(日本油 脂(株)製 パーヘキサ25B)1.0重量部を室温で ドライブレンドした後、シリンダー温度300℃、スク リュー回転数230rpmの条件で2軸押し出し機によ り押出して反応生成物を得た。この反応生成物のnsp /cは0、48であった。以下との反応生成物をマレイ 10 ン化PPEと略記する。との反応生成物は熱可塑性であ り、本発明の樹脂組成物の特性を損なわない範囲で添加 することができる。

[0097]

【実施例11】実施例7において、添加量55部のポリ マーAを44部とし、これに置き換える形で、参考例3 で合成したマレイン化PPEを11部添加した以外は、 実施例7と同一の組成で、同様な操作によって硬化物を 作成した。硬化物の特性は実施例7と大きな差がなく、 硬化物の外観、難燃性、ガラス転移温度および耐トリク す。

[0098]

【比較例1】実施例1において難燃剤の添加量を3重量 部とした以外は、実施例1と同様に操作して硬化物を作 成した。燃焼性試験を行ったところHB相当であった。 [0099]

【比較例2】実施例1において難燃剤の添加量を110 重量部とした以外は、実施例1と同様に操作して硬化物 を作成した。硬化物の外観は樹脂の流れ性不足のため不

30 良であった。表1に実施例1~11と合わせて比較例 1、2の結果を示す。

[0100]

【表1】

								組成(重量)	政)		硬化条件		- b)	C)	<b>1</b> €	雌燃性
	A	たはB	TAIC	/TAC	シリカ	水版709 93科7-	y7±chz (mtn)	//系媒燃剂	Sb,0,	部始前	<del>漢</del> (C)	崂	影響	於數 對1700 外額 111/性		SORTION CO.
英維例 1	A	75	TAIC	25	100	10	(515)	10	2	8	200	30	0	0	192	V-0
英籍例 2	В	75	TAIC	25	100	10	(\$ <del>1</del> 5)	10	2	В	200	30	0	0	192	V-0
実施例 3	Α	75	TAC	25	100	10	(5+5)	10	2	В	200	30	0	0	193	V-0
爽施例 4	A	65	TAIC	35	100	10	(5+5)	60	٥	6	200	30	0	0	197	V-0
実施例 5	В	65	TAIC	35	100	10	(5+5)	60	Q	6	200	30	0	0	197	V - 0
爽施例 8	A	65	TAIC	35	100	10	(414)	60	0	6	200	30	0	0	201	V-0
突旋例?	A	55	TAIC	45	100	10	(5+5)	20	4	В	200	80	0	0	198	V - 0
实施例 8	A	55	TAIC	45	200	10	(5+5)	20	4	В	200	30 .	0	0	188	V-0
実施例 9	A	55	TAIC	45	100	20	(5+5)	20	4	8	200	80	0	0	198	V-0
実施例10	В	55	TAIC	48	100	10	(5+5)	20	0	8	200	80	0	0	198	V - 0
実施例11	A	44 d)	TÁIC	45	100	10	(5+5)	20	4	8	200	80	0	0	201	V - 0
比較例 1	Α	75	TAIC	25	100	10	(\$+5)	3	2	8	200	80	0	0	208	HB
比較例 2	Α	75	TAIC	25	100	10	(5+5)	110	2	8	200	80	×	0	202	V-0

TAIC:トリアリルイソシアヌレート
TAC:トリアリルシアヌレート
TAC:トリアリルシアヌレート
a) 開始剤:2、5 - ジメチルー2.5 - ジ(t - ブチルパーオキシ)へキシン-3
b) 〇:外観は良好であった。
X:根原流れ天足であった。
c) ○:外観に変化はなかった。
d) 4 4 郷のポリマーAに加え、マレイン化PPBを11 郷承加してポリマー量を5 5 都とした。

#### [0101]

【実施例12~23】

#### 硬化性複合材料

表2に示した各々の組成で各成分をトルエン中に80℃ で溶解または分散させた。この溶液を50°Cに冷却して 50℃でガラスクロスを浸漬して含浸を行い、エアーオ ープン中で乾燥させた。

#### 【0102】積層体

成形後の厚みが約0.4mm~0.8mmになるように 上記の硬化性複合材料を必要に応じて複数枚重ね合わ せ、その両面に35μmの銅箔を置いて、表3に示す条 件でブレス成形機により成形硬化させて積層体を得た。 各実施例の硬化条件を表3に示した。成形圧力はいずれ も20kg/cm² とした。

【0103】とのようにして得られた積層体の諸物性を 以下の方法で測定した。

#### 1. 耐トリクロロエチレン性

銅箔を除去した積層体を25mm角に切り出し、トリク ロロエチレン中で5分間煮沸し、外観の変化を目視によ り観察した(JIS C 6481に準拠)。

#### 2. 誘電率、誘電正接

1MHzで測定を行った(JIS C 6481に準 拠)。

#### 3. ハンダ耐熱性

銅箔を除去した積層体を25mm角に切り出し、260 \*Cのハンダ浴中に120秒間浮かべ、外観の変化を目視 により観察した (JIS C 6481 に準拠)。

#### 4. 鋼箔引き剥し強さ

**積層体から幅20mm、長さ100mmの試験片を切り** 出し、銅箔面に幅10mmの平行な切り込みを入れた

後、面に対して垂直な方向に50mm/分の速さで連続 的に銅箔を引き剥し、その時の応力を引張り試験機にて 測定し、その応力の最低値を示した(JIS C 64 81に進拠)、

#### 5. ガラス転移温度(Tg)

積層体から切りだした試料をTMAによって測定した。 【0104】結果は表3に示した。いずれの実施例にお いても耐トリクロロエチレン性、耐熱性(Tgおよびハ ンダ耐熱性)、誘電特性、金属との接着性、難燃性に優 30 れた硬化複合材料、積層体が得られた。

#### [0105]

【実施例24】実施例18において、添加量55部のポ リマーAを44部とし、この減少分を置き換える形で、 参考例3で合成したマレイン化PPEを11部添加した 以外は、実施例18と同一の組成で同様に操作して硬化 物を作成した。硬化物の特性は実施例18と大きな差が なく、この実施例においても耐トリクロロエチレン性、 耐熱性(Tgおよびハンダ耐熱性)、誘電特性、金属と の接着性、難燃性に優れた硬化複合材料、積層体が得ら 40 れた。結果を表3に示す。

#### [0106]

【比較例3】実施例12において難燃剤の添加量を3重 量部とした以外は実施例8と同様に操作して硬化物を得 た。燃焼性試験を行ったところHB相当であった。

#### [0107]

(比較例4) 実施例12において難燃剤の添加量を11 0重量部とした以外は実施例12と同様に動作して積層 体を得た。銅箔引き剥し強度が実施例12に比べて著し く低下した。表3に実施例11~24と合わせて比較例 50 3、4の結果を示す。

[0108]

#### \* \*【表2】

	<u> </u>	遊材	85 (B)								
	AまたはB	TAIC /TAC	シリカ	水燃70, 7347~	972=61) (pin)	深難燃剤	Sb <sub>1</sub> O <sub>2</sub>	開始剤	超類	重量%	题
突迫例 1 2	A 70	TAIC 30	40	· 10	(515)	20	4	8	Bガラスクロス	65	0.8
突施例13	B 70	TAIC 30	40	10	(5 <del>1</del> 5)	20	4	6	<b>Eガラスクロス</b>	55	0.8
契选例 1 4	A 70	TAC 30	40	10	(545)	20	4	6	Eガラスクロス	55	0, 8
突旋例 1 5	A 60	TATE 40	40	10	(5+5)	40	8	6	Bガラスクロス	30	0.8
英施例 1 6	B 80	TAIC 40	40	10	(5+5)	40	8	6	Bガラスクロス	30	0.8
爽遊例 17	A 60	TAIC 40	40	10	(4+4)	40	В	6	<b>ピガラスクロス</b>	80	0.8
疾施例18	A 55	TAIC 45	40	10	(515)	20	. 4	6	Bガラスクロス	45	0.8
異施例18	A 55	TAIC 45	40	10	(515)	20	4.	6	Dガラスクロス	45	0.8
<b>英施例20</b>	A 55	TAIC 45	40	10	(5+5)	20	4	6	Bガラスクロス	45	0.4
奥施例21	A 55	TAIC 45	80	10	(5+5)	20	4	6	Bガラスクロス	45	0.8
爽施例22	A 55	TAIC 45	40	20	(5±5)	20	4	6	Bガラスクロス	45	0.8
実施例23	B 55	TAIC 45	40	10	(5+5)	20	4	6	Bガラスクロス	45	0.8
爽施例 2 4	A 44 b)	TAIC 45	40	10	(5+5)	20	4	6	Bガラスクロス	45	0.8
比较例3	A 70	TAIC 80	40	10	(5+5)	8	4	6	Bガラスクロス	66	0.8
比较例 4	A 70	TAIC 80	40	10	(5+5)	110	4	6	Bガラスクロス	55	0.8

TAIC :トリアリルイソシアヌレート TAC :トリアリルシアヌレート a) 開始朝:2.5-ジメチルー2.5-ジ(tーブチルペーオキシ) ヘキシン-3 b) 44部のポリマーAにマレイン(tPPBをLI部級加した。

[0109]

※ ※【表3】

	硬化条件 温度 時期 (で) (分)		a) 耐物四 环准		誘起率	誘電正接	。 ハンダ 耐熱性	録音引き 剣し強さ (kg/cn)	難燃性
	(6)	(34)		ļ				CHS/ CH/	
実施例 1 2	200	.30	0	205	3.3	0,002	0	1.4	V-0
実施例13	200	30	0	201	3, 3	0, 002	0	1.6	V - 0
実施例14	200	30	0	198	8.6	0.002	0	1.6	V - 0
英旌例 15	200	30	0	203	3.2	0,003	0	1. 2	V-0
実施例16	200	30	0	202	8. 3	0.003	0	1. 3	V - 0
実施例17	200	30	Q	201	3, 3	0, 003	0	1.3	V - 0
爽施例18	200	30	0	202	3.8	0.003	0	1.5	V - 0
実施例18	200	30.	0	205	3, 0	0, 002	0	1.5	V-0
実施例20	200	30	0	204	3, 3	0.003	0	1.5	V-0
実施例21	200	30	0	208	3. 3	0.003	0	1.5	V-0
実施例22	200	30	0	207	3. 8	0,003	0	1.5	V-0
実施例23	200	30	0	189	3, 3	0,003	0	1.8	V-0
実施例24	200	30	0	205	3, 8	0,003	0	1, 6	V-0
比較例3	200	30	0	204	3. 3	0.003	0	1, 5	нв
比较例 4	200	30	0	198	3.7	0.003	0	0.7	V-0

a) 〇:外観は良好であった。 ※: 施商、反りが認められた。

#### [0110]

【発明の効果】本発明の樹脂組成物は硬化前に良好な外 観を有するフィルム状、シート状あるいは硬化性複合材 料に予備成形できる。本発明の硬化樹脂組成物は難燃 性、耐熱性、耐薬品性および優れた誘電特性を兼ね備え ており、デカプロモジフェニルエーテルを含まない優秀 な材料である。

[0111]本発明の硬化性複合材料は金属との接着性 に優れる。また、本発明の硬化性複合材料を用いて得ら れる硬化複合材料および積層体は難燃性、耐熱性、耐薬 品性および優れた誘電特性を兼ね備えており、しかもデ カブロモジフェニルエーテルを含まない優秀な材料であ る。従って本発明の材料は、電気産業、電子産業、宇宙 50 ・航空機産業等の分野において誘電材料、絶縁材料、耐 (18)

特開平7-247415

34

33 熱材料等として用いることができる。特に本発明の硬化 性複合材料は片面、両面、多層プリント基板、セミリジット基板、金属ベース基板、多層プリント基板用プリブレグとして好適に用いられる。

\* [0112]また本発明の材料は、その耐熱耐吸湿絶縁性の故に線間100μm以下の高密度回路基板、層間絶縁層の厚み200μm以下の多層回路基板、実装用回路基板用の接着剤として良好に使用できる。

フロントページの続き

(51) Int.Cl. : 識別配号 庁内整理番号 F I

技術表示箇所

C 0 8 K 5/3477

C 0 8 L 53/02 L L Z

// B 3 2 B 15/08

J